证券代码：688372　证券简称：伟测科技　公告编号：2024-057

上海伟测半导体科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的基本情况

公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已于2024年7月18日完成股份登记工作，本次限制性股票归属新增的股份数量为460,867股。本次限制性股票归属后，公司总股本由113,373,910股增加至113,834,777股，公司注册资本变更为人民币113,834,777元。具体情况详见公司于2024年7月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-047）。

二、修订公司章程的情况

根据上述变更事项，公司拟对《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照				
序号	原章程内容		修订后内容	
	条目	条款内容	条目	条款内容
1	第六条	公司注册资本为人民币113,373,910元。	第六条	公司注册资本为人民币113,834,777元。
2	第十九条	公司股份总数为113,373,910股，均为普通股。	第十九条	公司股份总数为113,834,777股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。根据公司2022年年度股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：688372　证券简称：伟测科技　公告编号：2024-055

上海伟测半导体科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878号），公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,180.27万股，发行价为每股人民币61.49元，共计募集资金1,340,648,023.00元，坐扣承销和保荐费用78,162,309.27元后的募集资金为1,262,485,713.73元，已由方正承销保荐于2022年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25,306,164.68元后，公司本次募集资金净额为1,237,179,549.05元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-69号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	123,717.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	124,314.89
	利息收入净额	B2	1,313.46
本期发生额	项目投入	C1	575.68
	利息收入净额	C2	0.78
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	124,890.57
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,314.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2	141.62
实际结余募集资金		F	18.81
差异[注]		G=E-F	122.81

[注]差异一部分系公司使用自有资金支付30.95万元印花税所致，另一部分系无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目和集成电路测试研发中心建设项目全部投资款项支付完成之日时的节余募集资金以及后续产生的利息共计153.76万元转一般户补充流动资金所致，故实际募集资金结余较应结余募集资金少122.81万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同方正承销保荐、子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）和南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）于2022年10月21日、2022年12月8日分别与交通银行、平安银行、兴业银行、浦发硅谷银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金金额	备 注
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	133,156.52	募集资金专户余额
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567	54,918.99	募集资金专户余额
合 计		188,075.51	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目，2023年7月达到预定可使用状态，因此截至2024年6月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

2、集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，公司拟通过该项目进一步购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。通过该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品竞争力。

3、补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

4、“超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”均尚未达到预定可使用状态，暂时无法测算效益。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2024年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。　（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年半年度，公司不存在新增使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况

2024年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况

2024年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附件

上海伟测半导体科技股份有限公司

2024年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额				123,717.95		本报告期投入募集资金总额						575.68	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						124,890.57	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	否	48,828.82	48,828.82	48,828.82	0.00	48,797.15	-31.67	99.94	2023年7月	2024年1-6月实现营业收入8,852.20万元	不适用	否	
集成电路测试研发中心建设项目	否	7,366.92	7,366.92	7,366.92	0.00	7,408.42	41.50	100.56[注1]	2023年8月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,019.70	19.70	100.39[注1]	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	61,195.74	61,195.74	61,195.74	0.00	61,225.27	29.53	—	—	—	—	—	
超募资金项目													
超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	否	15,000.00	25,000.00	25,000.00	468.20	25,205.37	205.37	100.82[注1]	2027年10月	不适用	不适用	否	
超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	否	15,000.00	38,347.49	38,347.49	107.48	38,459.93	112.44	100.29[注1]	2024年12月	不适用	不适用	否	
超募资金项目小计		30,000.00	63,347.49	63,347.49	575.68	63,665.30	317.81	—	—	—	—	—	
合 计	—	91,195.74	124,543.23	124,543.23	575.68	124,890.57	347.34	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金其他使用情况		不适用											

[注1]集成电路测试研发中心建设项目、补充流动资金项目、伟测半导体无锡集成电路测试基地项目、伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入。

证券代码：688372　证券简称：伟测科技　公告编号：2024-056

上海伟测半导体科技股份有限公司关于申请增加2024年度银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于申请增加2024年度银行授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

为满足公司及全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）、南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）、深圳伟测半导体科技有限公司（以下简称“深圳伟测”）及天津伟测半导体科技有限公司（以下简称“天津伟测”）的日常生产经营等相关资金需求，便于公司各项业务正常开展，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币2.5亿元银行授信额度。本次增加人民币2.5亿元银行综合授信额度后，公司及子公司2024年可向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币14.40亿元。具体增加授信明细如下：

单位：万元

序号	授信方	授信金额	授信期限	额度使用单位
1	兴业银行股份有限公司	10,000	1年	公司及无锡伟测、南京伟测、深圳伟测、天津伟测
2	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	10,000	2年	公司
3	交通银行股份有限公司无锡区支行	5,000	1-3年	无锡伟测
合计		25,000	——	——

上述授信业务类型包括但不限于办理中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务。具体授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

签订上述授信额度相关协议的有效期为自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率，董事会授权公司董事长骈文胜先生或其授权代表在上述授信额度范围内审核并签署相关合同文件。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：688372　证券简称：伟测科技　公告编号：2024-053

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年8月29日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜公司2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

董事会审计委员会对本项议案进行了事前认可。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

监事会对本项议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于申请增加2024年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请增加2024年度银行授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于＜2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》及《公司章程（2024年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

公司代码：688372　公司简称：伟测科技

上海伟测半导体科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	伟测科技	688372	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王涵	
电话	021-58958216	
办公地址	上海市浦东新区东胜路38号D1栋	
电子信箱	ir@vt-test.com.cn	

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,004,915,957.44	3,608,104,998.73	11.00
归属于上市公司股东的净资产	2,467,069,908.20	2,458,667,718.78	0.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	429,915,232.67	311,882,355.75	37.85
归属于上市公司股东的净利润	10,856,629.28	70,763,441.25	-84.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,217,706.33	52,647,647.44	-91.99
经营活动产生的现金流量净额	202,407,009.95	179,217,674.73	12.94
加权平均净资产收益率(%)	0.44	2.95	减少2.51个百分点
基本每股收益(元／股)	0.10	0.81	-87.65
稀释每股收益(元／股)	0.10	0.81	-87.65
研发投入占营业收入的比例(%)	15.00	12.40	增加2.60个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					6,615		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海蕊测半导体科技有限公司	境内非国有法人	31.00	35,142,689	35,142,689	35,142,689	无	0
深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	其他	6.11	6,925,771	0	0	无	0
江苏灌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.08	6,896,131	0	0	无	0
苏民无锡智制造产业投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	5.37	6,089,871	0	0	无	0
苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.28	5,986,327	0	0	无	0
宁波芯伟半导体科技合伙企业(有限合伙)	其他	2.58	2,921,970	0	0	无	0
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	其他	2.48	2,812,021	0	0	无	0
南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.23	2,527,090	0	0	无	0
顾成标	境内自然人	1.77	2,009,380	0	0	无	0
涂浩	境内自然人	1.55	1,757,872	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、控股股东蕊测半导体与其他股东无关联关系或一致行动关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688372　证券简称：伟测科技　公告编号：2024-054

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜公司2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与《公司2024年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2024年半年度报告》及其摘要的内容。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关制度的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于申请增加2024年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请增加2024年度银行授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临2024-067

兰州兰石重型装备股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年9月9日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603169	兰石重装	2024/9/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：兰州兰石集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2024年8月23日公告了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-063），直接和间接合计持有46.09%股份的公司控股股东兰州兰石集团有限公司，在2024年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年8月29日，公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。为提高决策效率，控股股东兰州兰石集团有限公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年8月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月9日 14点00分

召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月9日

至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》及相关制度的议案	√
2	关于注册发行中期票据的议案	√
3	关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司＜章程＞及相关制度的公告》（临2024-060）、《关于注册发行中期票据的公告》（临2024-061）。

议案3已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临2024-067）。

2. 特别决议议案：议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年8月30日

● 报备文件

《兰州兰石集团有限公司关于在兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第四次临时股东大会上增加临时提案的函》

附件：授权委托书

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司《章程》及相关制度的议案			
2	关于注册发行中期票据的议案			
3	关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临2024-066

兰州兰石重型装备股份有限公司关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“兰石重装”）控股股东，系公司关联法人；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团向兴业银行兰州分行申请综合授信提供担保，担保额度不超过25,000万元。截至本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为25,000.00万元（不含本次）；

● 本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石建设工程有限公司（以下简称“兰石建设”）提供保证反担保；

● 对外担保逾期的累计数量：无；

● 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司控股股东兰石集团根据资金筹划安排，拟向兴业银行兰州分行申请综合授信，额度不超过25,000万元，期限1年。本着相互协同、共促发展原则，公司拟为兰石集团本次向兴业银行兰州分行申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由兰石集团全资子公司兰石建设提供保证反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

由于兰石集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易。2024年8月29日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，在关联董事张凯、李剑冰回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

根据公司《章程》相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：兰州兰石集团有限公司

2. 统一社会信用代码：91620100224469959T

3. 成立日期：1992年12月12日

4. 注册资本：177,286.3092万元

5. 注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路194号

6. 法定代表人：王彬

7. 主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻采装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

8. 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.6.30(未经审计)
资产总额	3,422,053.77	3,428,024.26
负债总额	2,608,918.14	2,633,139.70
净资产	813,135.62	794,884.55
	2023年度	2024年1-6月
营业收入	801,290.10	374,966.10
净利润	13,291.41	-14,264.83

9. 与上市公司关联关系：兰石集团为公司控股股东，截止目前，兰石集团直接持有本公司41.19%的股份，与一致行动人合计持有本公司46.09%的股份。

三、担保的主要内容

公司为控股股东兰石集团向兴业银行兰州分行申请授信额度25,000.00万元提供连带责任担保，期限为一年。上述兰石集团的实际授信额度以兴业银行兰州分行最终审批的授信额度为准。

四、担保的必要性和合理性

兰石集团目前经营情况正常，具备债务偿还能力，担保风险可控。兰石集团长期支持上市公司的发展，本着相互协同、共促发展原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，公司向兰石集团提供担保是可行的，风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次公司为兰石集团提供的担保，由兰石建设提供保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。

反担保协议主要内容如下：

1. 反担保的范围：

（1）兰石重装代兰石集团向债权人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而产生的全部费用；

（2）兰石重装代兰石集团清偿上述款项所产生的其他费用及损失；

（3）兰石重装向债权人承担担保责任后，向兰石集团追偿所产生的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等)；

（4）兰石重装为实现本协议项下反担保债权所产生的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费拍卖费、保险费及审计评估费等)。

2. 反担保的担保期间：

反担保的担保期间自反担保协议生效之日起至债权债务解除之日为止。

五、董事会意见

（一）董事会意见

兰石集团不存在银行贷款逾期情形，鉴于兰石集团长期支持上市公司的发展，本着相互协同、共促发展原则，本次公司为兰石集团向兴业银行兰州分行申请综合授信业务提供担保，有利于实现双方共同发展，且被担保方提供了相应的反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）独立董事专门会对本次关联担保的审核意见

公司为控股股东兰石集团向兴业银行兰州分行申请综合授信业务提供担保是本着相互协同、共促发展原则，且兰石集团经营情况正常，具有较强的抗风险能力，并为本次担保提供了足额反担保，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十五次会议审议，同时，关联董事应回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为73,393.72万元（不含此次担保），占公司2023年度经审计归属于母公司